tSML - LWL Teilfrontplatte Snap-In mit 6x MPO/MTP® Key Up/Down OM3 Grün für tSML Modul 0.5HE

\*\*tSML - tde Semi Modular Link

tSML ist ein modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus zwei Kernkomponenten besteht: Modul und Trunkkabel. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die LWL und TP Module können mit ihren Abmessungen von 19" 0,5HE zusammen innerhalb einer Höheneinheit mit sehr hoher Portdichte kombiniert eingesetzt werden. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports sind so auf 1HE möglich. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP® und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.

\*\*tSML - LWL/TP Breakout Modul Zubehör

Die tSML – LWL Teilfrontplatte MPO/MTP®ist für den Einbau im 0.5HE tSML - Modul vorgesehen.

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

|  |  |
| --- | --- |
| Bestückung | 6 x MPO/MTP®Adapter (grün) |
|  | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |

\*\*\*tML® Standard - LWL Module MPO/MTP®

|  |  |
| --- | --- |
| Frontplatte | Edelstahl |
| Abmessungen | 108 x 20 mm |

\*\*\*LWL Adapter

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | MPO/MTP® |
| Anwendung | Singlemode OS2 APC |
| Bauform | ohne Flansch |
| Einbauform | SC Simplex |
| Orientierung | Typ A, Key up/down |
| Farbe | Grün |
| Material | Kunststoff |
| Hülse | -- |
| Klappe | -- |
| Standards | IEC 61754-7 TIA 604-5 |
| Hersteller | US Conec |